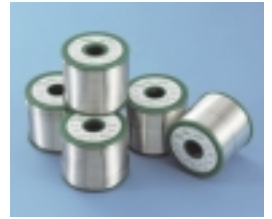


松脂錫絲

Flux-cored Solder Wire

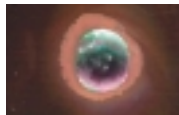
類型 Type	免洗高活性型 No-Clean High Activity				助焊劑殘渣透明型 No-clean Clear Residue	汎用型 General Type	
	JIS 3283 AA級		JIS 3283 A級		JIS 3283 A級	JIS 3283 B級	
助焊劑 Flux type	010	011	020	210	110M	203	
合金 Alloy	SN100C · SN96CI · SN97C, etc.						
特性 Properties	助焊劑含量 Flux content mass%	3.0, 4.0			2.5	2.0	
	鹵素含量 Halide content %	≤0.05	≤0.04	0	≤0.4	≤0.4	≤0.9
	水溶液阻抗 Resistivity of water extract Ωm	≥2000	≥3000	≥1000	≥500	≥1000	≥500
	表面絕緣電阻 SIR Ω 85°C 85%RH梳形基板 II Comb Pattern II	≥1.0 × 10 ¹⁰	≥1.0 × 10 ¹⁰	≥1.0 × 10 ¹⁰	≥1.0 × 10 ⁹	≥1.0 × 10 ⁹	≥1.0 × 10 ⁹
	* 擴散率 Spread factor %	≥75	≥80	≥80	≥70	≥70	≥75
線徑 Diameter	0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 mm						



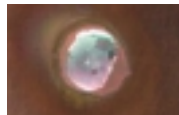
試驗方法 Test method: 同 JIS Z 3197-1999

* 擴散率：因不同合金、助焊劑含量多寡、線徑粗細、所得數值亦不同。(使用SN100C焊錫) * Spread is dependent on alloy composition, flux % and diameter. (used Alloy: SN100C at 300°C)

- 焊錫擴散實驗(依本公司試法)
Spreading test



SN100C (011) 4%

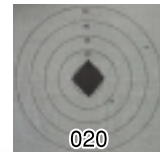


SN100C (011) 3%

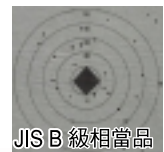
- 飛濺試驗(依SN100C#020)
Less Spattering 020type

錫珠飛濺個數

020	2個
JIS B 級相當品	30個



020



JIS B 級相當品

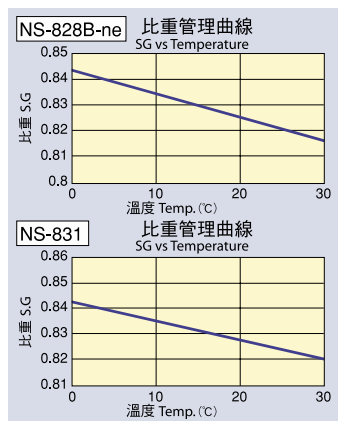
助焊劑

Flux

適用於無鉛焊錫之高活性、高可靠性的助焊劑。錫橋·錫尖少而且爬升性良好。

Both of NS-828B-ne and NS-831 are a robust, high activity flux with all the properties necessary to get reliable joints in lead-free soldering.

項目 Item	NS-828B-ne	NS-831	測試方法 Test method
助焊劑類型 Flux type	無光澤 Matt finish	無光澤 Matt finish	目視 visual observation
比重 S.G. 20°C	0.826	0.828	JIS Z 3197 6.4
固體含量 Solid content mass%	17	14.5	145°C 15min.
鹵素含量 Halide content %	0.08	0.07	JIS Z 3197 6.5
銅片腐蝕試驗 Corrosion test on copper plate	無腐蝕 Passed	無腐蝕	JIS Z 3197 6.6.1
表面絕緣電阻 SIR Ω	初期值 Initial value	≥ 1.0 × 10 ¹³	JIS Z 3197 6.8
	1000小時後 After 1000hrs	≥ 1.0 × 10 ¹¹	
外加電壓耐濕性 Ω Electromigration	初期值 Initial value	≥ 1.0 × 10 ¹³	JIS Z 3197 6.9
	1000小時後 After 1000hrs	≥ 1.0 × 10 ¹¹	
擴散率 Spread factor %	≥85	≥75	JIS Z 3197 6.10
酸值 Acid value mgKOH/g	32	34	JIS-K-59025.4
引火點 Flash point °C	12	12	
用途 Application	發泡·浸漬·人工塗抹 for foaming, dipping, brushing	噴霧·發泡·浸漬·人工塗抹 for spray, foaming, dipping, brushing	



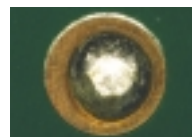
- 通孔爬升性比較



焊墊徑 2.0mm 孔徑 1.0mm



NS-831



以前

BGA·CSP用錫球

BGA·CSP Sphere

SN100C·SN96CI·SN97C

直徑 0.1 ~ 0.9mm (±10µm)。建議使用與助焊劑 RM-5 一起。

0.1 ~ 0.9mm diameter(±10µm) For best soldering use the compatible flux RM-5.

BGA/CSP 錫球用之助焊劑

RM-5 Flux for BGA/CSP

項目 Item	RM-5	測試方法 Test method
鹵素含量 Chloride content %	0.02±0.005	JIS Z 3197 6.5
擴散率 Spread factor %	≥ 80	JIS Z 3197 6.10
表面絕緣電阻 SIR Ω	初期值 Initial value	≥ 1.0 × 10 ¹³
	96小時後 After 96hrs	≥ 1.0 × 10 ¹¹
外加電壓耐濕性 Ω Electromigration	初期值 Initial value	≥ 1.0 × 10 ¹³
	96小時後 After 96hrs	≥ 1.0 × 10 ¹¹
用途 Application	印刷塗抹用 for printing	

